证券代码: 300751 证券简称: 迈为股份

苏州迈为科技股份有限公司

2023年9月22日投资者关系活动记录表

编号: 2023-004

投资者关系活动类别	│ │□特定对象调研 │	□分析师会议
	│□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	☑路演活动
	□现场参观	□电话会议
	□其他: <u>(请文字说明其他活动内容)</u>	
参与单位名 称及人员姓 名	HSBC Asset Management、HSBC Global Asset Management、HSZ Grouo、Pinpoint、Taikang Asset management、Pacific crest partners、Fosun Hani Asset Management、Haitong International AM、Manulife、Millennium、Ortus Capital、Passage Investment Management、Prudence、SinoPac Asset Management (Asia) Limited等机构投资者14人	
时间	2023年9月22日14:30-15:30, 15:30-16:30	
地点	香港国际金融中心一期	
公司接待人 员姓名	证券部总监谭静女士	
	简要介绍公司情况(详见附件)	
投资者关系 活动	问答环节: 1、公司无主栅技术技术的进展情况?	
主要内容介		
绍	答:公司积极推动前置焊接的无主栅技术(NBB),该技术去除了电池的全部主栅	
	线,可将银浆耗量减30%以上,且在焊持	妾工序即形成有效的焊接合金层, 在提升组件

功率及可靠性的同时,降低了制造成本。

公司与客户达成 20GW 异质结 NBB 串焊机战略合作,相关量产设备已开始交付给客户。

2、公司如何看待 BC 相关的电池片路线,是否有技术储备?

答: BC 技术包括了 IBC、HPBC、TBC、HBC 等,公司对相关技术有所储备。公司坚定看好 HJT 技术,努力推动 HJT 技术的应用和发展并做好相关设备。目前,公司的丝网印刷设备、激光设备适用于各类 BC 技术路线;公司正在进行研发的铜电镀整线装备可用于 HBC、TBC 等技术路线,公司的板式 PECVD、PVD 可用于 HBC 电池的制备。

3、上半年增收不增利的主要原因?

答:各项费用前置导致营业利润增速相对放缓。由于订单饱满,员工增幅较大,导致人员薪酬和差旅费增加较多;公司对研发投入保持了较高的水平,对光伏和半导体封装等方向的新技术持续投入。

HJT 规模量产初期存在产线改造的情况且制造尚未形成规模效应,影响了部分订单的毛利率。上述影响随着设备方案完善和成本管控或将逐渐减少。

4、零部件国产化是否有进展?

答:目前公司倾向使用稳定性更好的零部件,压缩产线爬坡时间。公司积极而审慎推进零部件国产化。

5、公司目前海外订单的状态和未来预期?

答: 2023 年上半年公司来自海外的收入同比有所增长,之前签订的订单正按照合同履行中。海外光伏主要应用市场国家大力推动本国光伏产业,海外客户扩产趋势明显。由于异质结在自动化和无人化方向上的优势,公司判断异质结技术有望成为海外电池片发展的主流。

6、公司铜电镀是否有进展?

答:公司正在进行铜电镀整线装备的研制,包括核心环节的 PVD 镀种子层设备、图形化设备等。预计,公司铜电镀整线设备年底之前会搬入客户端工厂进行中试。

7、公司对未来电池技术的发展方向如何展望?

答:公司认为异质结与钙钛矿叠层电池是未来行业发展的主赛道。异质结与钙钛矿电池有良好的匹配性:异质结作为底电池可以充分发挥其开压高的优点;大部分异质结的镀膜设备、低温浆料都能用在异质结钙钛矿叠层上;现有的世界纪录以及相关研究都是基于异质结作为底电池。

8、公司非光伏板块业务的进展?

答:公司非光伏业务主要集中在面板显示、半导体封测环节。目前已经在显示领域布局了OLED 柔性屏激光切割设备、Micro LED 激光剥离设备、巨量转移设备、激光键合和 Mini LED 晶圆隐切设备等设备;在封测环节布局了刀轮切割、激光改质切割、激光开槽设备等设备。公司在客户端验证的设备表现良好。

附件清单	公司介绍
日期	2023年9月22日





我们的愿景

致力于成为全球领先的泛半导体装备制造商

我们的使命

通过创新推动行业进步,为客户提供最先进、最稳定、 最具性价比的设备及最优良的服务

我们的价值观

成就客户 负责·合作 效率·创新 温度·分享

■ 关于迈为

迈为股份

泛半导体高端装备制造商

苏州迈为科技股份有限公司(简称"迈为股份",股票代码: 300751)于2010年9月成立,是一家集机械设计、电气研制、软件开发、精密制造于一体的高端装备制造商,公司面向太阳能光伏、显示、半导体三大行业,研发、制造、销售智能化高端装备,主要产品包括全自动太阳能电池丝网印刷生产线、异质结高效电池制造整体解决方案、OLED柔性屏激光切割设备、MLED全线自动化设备解决方案、半导体晶圆封装设备等。

立足**真空、激光、精密装备**三大关键技术平台,秉持以自主研发与技术创新实现核心设备国产化的信念,迈为股份始终以行业顶尖水平为标准,持续探索、致力成为泛半导体领域细分行业标杆,推动智能化制造技术的进步。

990000 m² 三大制造基地 超过

10000 m² 四大实验室 超过

16家子公司

204亿

数据来源: 总资产_2023年企业半年度报告; 其他 2022年企业年度报告。













■ 发展历程

创新驱动发展, 科技引领未来

2010

► 吴江迈为技术有限公司成立 (后更名为"苏州迈为科技股份有限公司")

2016

- ▶ 迈为63亩智能制造产业园开工建设
- ▶ 迈为太阳能电池丝网印刷生产线 国内市占率跃居第一

2019

- ▶ 国内首台OLED G6 Half激光切割量产设备交付
- ▶ 国内首套年产能250MW异质结高效电池量产设备交付
- ▶ 迈为63亩智能制造产业园投产

2022

- ▶ 迈为283亩总部产研中心、迈为238亩珠海半导体装备 产业园开工建设
- ▶ 成功交付业内首套双面微晶异质结高效电池整线设备
- ▶ 成功研发并交付半导体晶圆研磨设备
- ▶ 成功研制量产Micro LED巨量转移设备

2023

- ▶ 成功研发并交付半导体晶圆刀轮 切割设备
- ▶ 成功研发半导体晶圆等离子体切割设备

2008

▶ 迈为太阳能电池丝网印刷 生产线立项研发

2012

- ▶ 取得第一项发明专利——《一种角度可调整的丝网印刷及其角度调整装置》
- ▶ 取得第一项软件著作权——《太阳能电池 丝网印刷控制系统软件》

2018

- ▶ 迈为股份在深交所上市,股票代码:300751
- ▶ 迈为太阳能电池丝网印刷生产线全球市占率跃居第一

2021

- ▶ 异质结高效电池整线设备首次出口海外,全球市占率跃居第一
- ▶ 成功研发并交付半导体晶圆激光开槽设备、激光改质切割设备
- ▶ 成功研发Mini LED晶圆划裂设备、Micro LED晶圆剥离设备

MAXWELL

全球布局

迈为股份自主研发的太阳能电池丝网印刷生产线、异质结 高效电池整线设备不仅打破了该设备领域进口依赖的格局。 还远销海外市场, 在国际上树立了优质的国产品牌形象。



太阳能电池丝网印刷生产线 全球市占率第1

异质结高效电池生产线 全球市占率第1

■ 合作客户

























































































































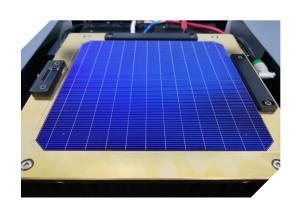




■ 科研创新

四大实验室

以资深研发团队和充沛研发投入为基石,迈为股份建立了四大实验室,从客户角度出发,围绕装备、材料、量产、成本等重点进行延伸研发,为客户的产品制造提供整体工艺解决方案。



▲ 高效太阳能电池实验室

具备完整的HJT高效太阳能电池中试线,可快速 推进PECVD、PVD等设备的自主设计开发、核 心部件论证优化、电池技术和整线工艺升级。

▼ 组件技术实验室

可独立完成HJT高效组件的制造及电学性 能测试,对于光伏组件可靠性检验及HJT 组件的工艺优化具有重要意义。



WAXWELL

◀ 激光实验室

可独立进行OLED柔性屏激光设备、 Mini/Micro LED晶圆设备、半导体晶圆 设备的研发以及工艺解决方案的优化。

分析检测中心

可独立进行非晶硅薄膜、TCO薄膜性能及其 他先进薄膜和原材料的测试分析,用于高效 电池设备技术的研发和整线生产工艺优化。



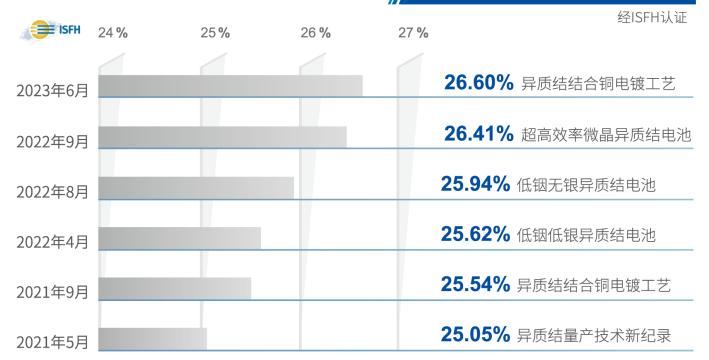


■ 科研创新

技术引领

采用自主研发的异质结电池量产装备,多次实现异质结电池在相关领域的效率纪录突破。

// 迈为实验室异质结电池效率攀升进程











光伏

太阳能电池设备领军者

太阳能电池丝网印刷整线设备

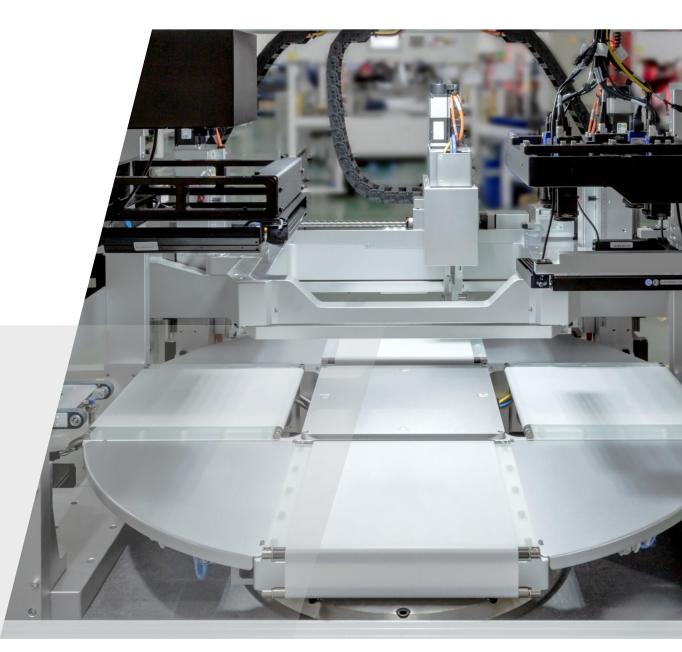
凭借自主研发创新,迈为取得多项关键技术突破,不仅达成了该设备的国产化,还实现了高端装备领域少有的对外出口,赢得国内及全球市场领先地位。

异质结高效电池制造整体解决方案

2019年起,迈为率先成功研制并推出三代**高效率、大产能、低成本**的异质结电池整线设备。最新一代产品——**双面微晶**异质结高效电池整线设备于2022年末开始交付客户。双面微晶技术的应用可以让电池片透光性更好、导电性更佳,有效提升异质结电池的光电转换效率。

太阳能电池激光设备

公司成功研制了高速PERC激光开槽设备、SE激光扩散设备等,在细分领域 赢得一定市场份额。







显示

OLED激光切割设备破局者

自2017年起,迈为面向显示行业布局,自主研发并且率先实现了 OLED G6 Half激光切割设备、OLED弯折激光切割设备的国产化,产品量产稳定性、产量、良率均处于行业前沿水平。

主要产品

(屏体)OLED柔性屏激光切割设备 (屏体)OLED柔性屏自动激光修复设备 (模组)OLED柔性屏激光异形切割设备 (模组)OLED柔性屏激光打孔设备 (模组)OLED柔性屏激光打标设备



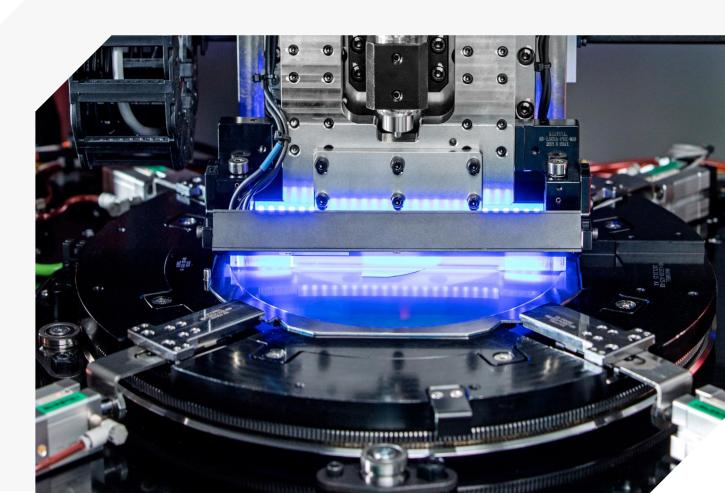
显示

MLED全线设备方案开拓者

自2020年起,公司将业务延伸至新型显示领域,针对Mini LED 自主研发了晶圆隐切、裂片、刺晶巨转、激光键合等全套设备, 针对Micro LED自主研发了晶圆键合、激光剥离、激光巨转、激 光键合和修复等全套设备,为MLED行业提供整线工艺解决方案。

主要产品

Mini LED晶圆激光改质切割设备
Mini LED晶圆劈裂设备
Mini LED晶圆激光巨量键合设备
Mini LED晶圆刺晶巨量转移设备
LED晶圆激光表切设备
Micro LED晶圆激光剥离设备
Micro LED晶圆巨量键合设备
Micro LED晶圆激光巨量转移设备





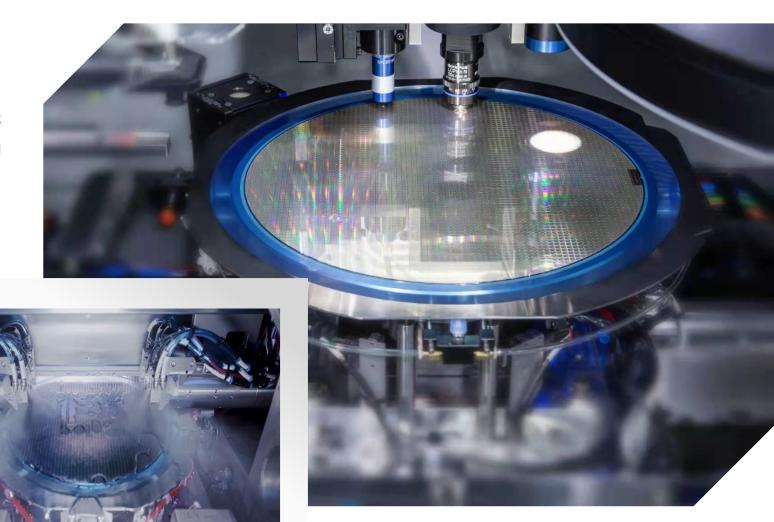
半导体

半导体封装设备创新者

作为半导体装备领域的新生力量,公司率先实现了半导体晶圆激光开槽、激光改质切割、刀轮切割、研磨等装备的国产化,并聚焦半导体泛切割、2.5D/3D先进封装,提供封装工艺整体解决方案。

主要产品

半导体晶圆刀轮切割设备 等离子体半导体晶圆切割设备 半导体晶圆激光开槽设备 半导体晶圆激光改质切割设备 半导体晶圆研磨设备 半导体背面减薄磨轮





■社会责任

在发展的同时,迈为时刻不忘回报社会,传递向上向善的力量,关注并积极投入慈善等社会公益活动,践行企业社会责任,致力为社会的可持续发展作出贡献。



善行公益

2019年-2023年,迈为股份累计向苏州市吴江区捐赠600万元,用以回馈当地、传递爱心,帮助寒门学子、贫困家庭、孤寡老人等社会弱势群体。

关爱员工

迈为珍视、尊重、爱护每一名员工,努力为其营造安全、健康、 愉快的工作环境,保障员工身心健康的同时,为其提供广阔的职 业发展空间。

公司建立了"迈为健康之家"心理及医疗健康咨询室,迈为落实着对员工的爱护,不断提升其工作幸福指数。

关爱环境

迈为在厂区屋顶建设了1775kW分布式光伏发电系统,用作停车场 遮阳棚,年发电量约177.99万度电,相当于减少了177.46万千克 二氧化碳排放量。

迈为关爱环境,在创造经济价值的同时主动承担环境保护责任、 善用能源,为地球的绿色未来贡献力量。